

温州长期回收IC芯片 合作收购库存IC呆料

产品名称	温州长期回收IC芯片 合作收购库存IC呆料
公司名称	深圳市铭盛电子科技有限公司
价格	168.00/个
规格参数	铭盛电子科技:13631665055 型号:KA3525A 加微:长期合作
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦
联系电话	0755-83292099 13534023459

产品详情

温州长期回收IC芯片 合作收购库存IC呆料

DSO(dual small out-lint)

双侧引脚[小外形封装](#)。SOP 的别称(见[SOP](#))。部分半导体厂家采用此名称。

14、DICP(dual tape carrier package)

双侧引脚带载封装。TCP(带载封装)之一。引脚制作在绝缘带上并从封装两侧引出。由于利用的是TAB(自动带载焊接)技术，封装外形非常薄。常用于液晶显示驱动LSI，但多数为定制品。

另外，0.5mm厚的存储器LSI

簿形封装正处于开发阶段。在日本，按照EIAJ(日本电子机械工业)会标准规定，将DICP 命名为DTP。

15、DTP(dual tape carrier package)

同上。日本电子机械工业会标准对DTCP 的命名(见DTCP)。

FP(flat package)

扁平封装。表面贴装型封装之一。QFP 或[SOP](#)(见QFP 和SOP)的别称。部分半导体厂家采用此名称。

17、flip-chip

[倒焊芯片](#)。裸芯片封装技术之一，在LSI

芯片的电极区制作好金属凸点，然后把金属凸点与印刷基板上的电极区进行[压焊](#)连接。封装的占有面积基本上与[芯片尺寸](#)相同。是所有封装技术中体积最小、最薄的一种。

但如果基板的热膨胀系数与LSI芯片不同，就会在接合处产生反应，从而影响连接的可靠性。因此必须用树脂来加固LSI芯片，并使用热膨胀系数基本相同的基板材料。

18、FQFP(fine pitch quad flatpackage)

小引脚中心距[QFP](#)。通常指引脚中心距小于0.65mm的QFP(见QFP)。部分导体厂家采用此名称。